SYS-CLEAN® WIPES1.0



Reinigungstücher – ready-to-use

SYS-CLEAN® WIPES1.0 sind spezielle Reinigungstücher zur Vorreinigung von SMT-Druckschablonen und sonstigen Edelstahloberflächen, sowie Rakeln, Spachteln etc.. SYS-CLEAN® WIPES1.0 sind mit einem optimierten wasserbasierten Reinigungsmedium getränkt und sofort einsatzbereit. Durch den unaufdringlichen Geruch ist die Handhabung angenehm.

Der verwendete Reiniger in den SYS-CLEAN® WIPES1.0 ist identisch mit unserem SYS-CLEAN® STC1.0.



Anwendungsbereich

Verschmutzung	Eignung
Lotpasten ungelötet	>
SMT-Kleber bzw. Leitkleber	>
Flussmittel ungelötet	* *
Öle/Fette	*



Technische Daten SYS-CLEAN [®] Wipes1.0 werden in Spenderdosen und Nachfüllpacks ausgeliefert.		
pH-Wert	6,1	
Dichte (bei 20°C)	0,999 g/cm³	
Brechungsindex (bei 20°C)	N.A.	
Flammpunkt	>100 °C	
Siedebeginn und Siedebereich	100 °C	

SYS-CLEAN[©] WIPES1.0



Reinigungstücher – ready-to-use

Anwendungsart		
Sprühreinigung	×	
Tauchreinigung – Perlator	×	
Tauchreinigung – Sprühsystem	×	
Ultraschallreinigung	×	
Manuell	* *	

/	✓ = Exzellent	✓ = Optimal	= Optional	= Nicht Empfohlen
----------	----------------------	-------------	------------	-------------------

Vorteile:

Die Tücher sind optimal für die Reinigung von nicht ausgehärtetem Kleber und Pasten geeignet.

Bitte um Beachtung:

Die Tücher nicht auf lackierten Oberflächen benützen.

Verfügbarkeit:

SYS-CLEAN® WIPES1.0 sind in folgenden Größen erhältlich

Artikelnummer für Spenderdose: 64903543 Artikelnummer für Nachfüllpack: 64903626



Das Produkt ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen gemäß der SIN- & SVHC-Listen

